

Kurzbeschreibung:

CuNex ist spezialisiert auf neuartige Kupferpasten und Kupferpreforms für Sinterprozesse (Die-Attach-, Substrat-Attach, Topside-Attach) in der Mikroelektronik.

Als Ausgründung der TH Ingolstadt und SCHLENK als Fertigungspartner mit 150-jähriger Erfahrung in der Metallverarbeitung ist CuNex seit 2023 auf dem Markt. Die kupferbasierten Sintermaterialien werden in Roth hergestellt und ermöglichen druckarmes und schnelles Sintern bei hoher Zuverlässigkeit und Leitfähigkeit sowie flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Die Cuprum-Sinterpasten und CuForm-Preforms eignen sich für das Sintern von Si-, SiC- und GaN-Halbleiter, Hochleistungs-LEDs sowie AMB- und DBC-Substrate und Kühlkörper. Im Gegensatz zu Silbersinterpasten können die Sinterkosten um bis zu 70-80% reduziert werden. Aufgrund des Einsatzes von Kupferpulvern auf Mikropartikelbasis – die in-house bei SCHLENK hergestellt werden – kommt die Technologie ohne toxische Nanopartikel aus.



Produktspektrum/Dienstleistungsangebot:

kupferbasierte Sinterpasten und Sinter-Preforms

Branchen:

Automotive, Mikroelektronik, Luft-/Raumfahrt, Batterie

Neuheiten/Innovationen/derzeitige Aktivitäten:

Ausstellung auf der PCIM Europe 2026 mit neuesten Langlebigkeitsanalysen

Webseite: www.cunex.de

Ansprechpartner: Sri Krishna Bhogaraju, srikrishna.bhogaraju@cunex.de